

環境負荷低減！低融点ペースト！

Reduced environmental impact! Low temperature solder paste!

SB58-COSMO-NH-T4 SB35-COSMO-NH-T4

低融点組成で常温輸送、常温保管が可能

Low temperature solder paste to enable room temperature transport and storage

ROLO対応品

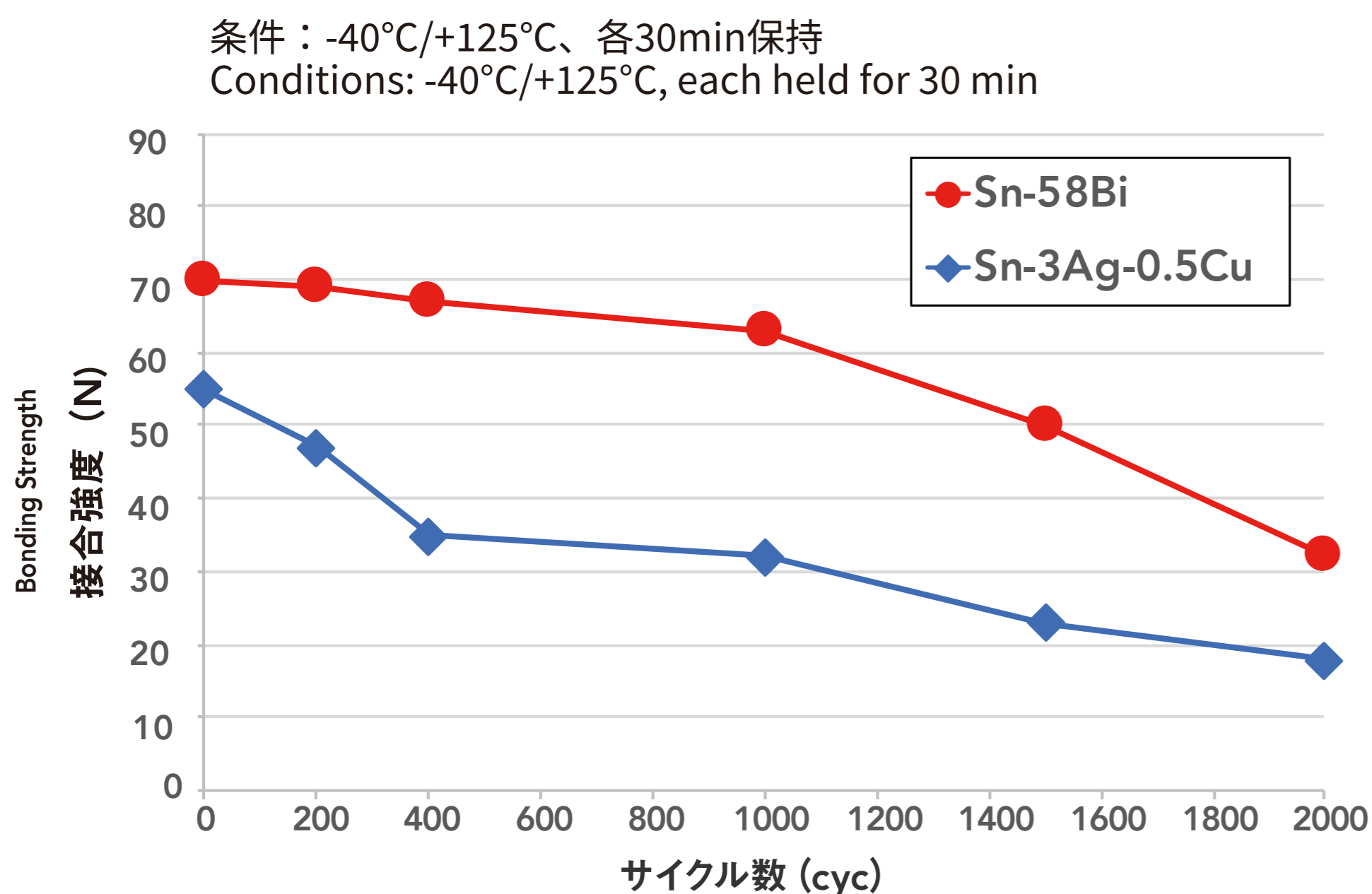
ROLO support

Sn-58Bi 組成と Sn-35Bi 組成の 2 種類用意

Two types of Sn-58Bi and Sn-35Bi compositions are available

熱衝撃試験比較

Thermal Shock Test Comparison

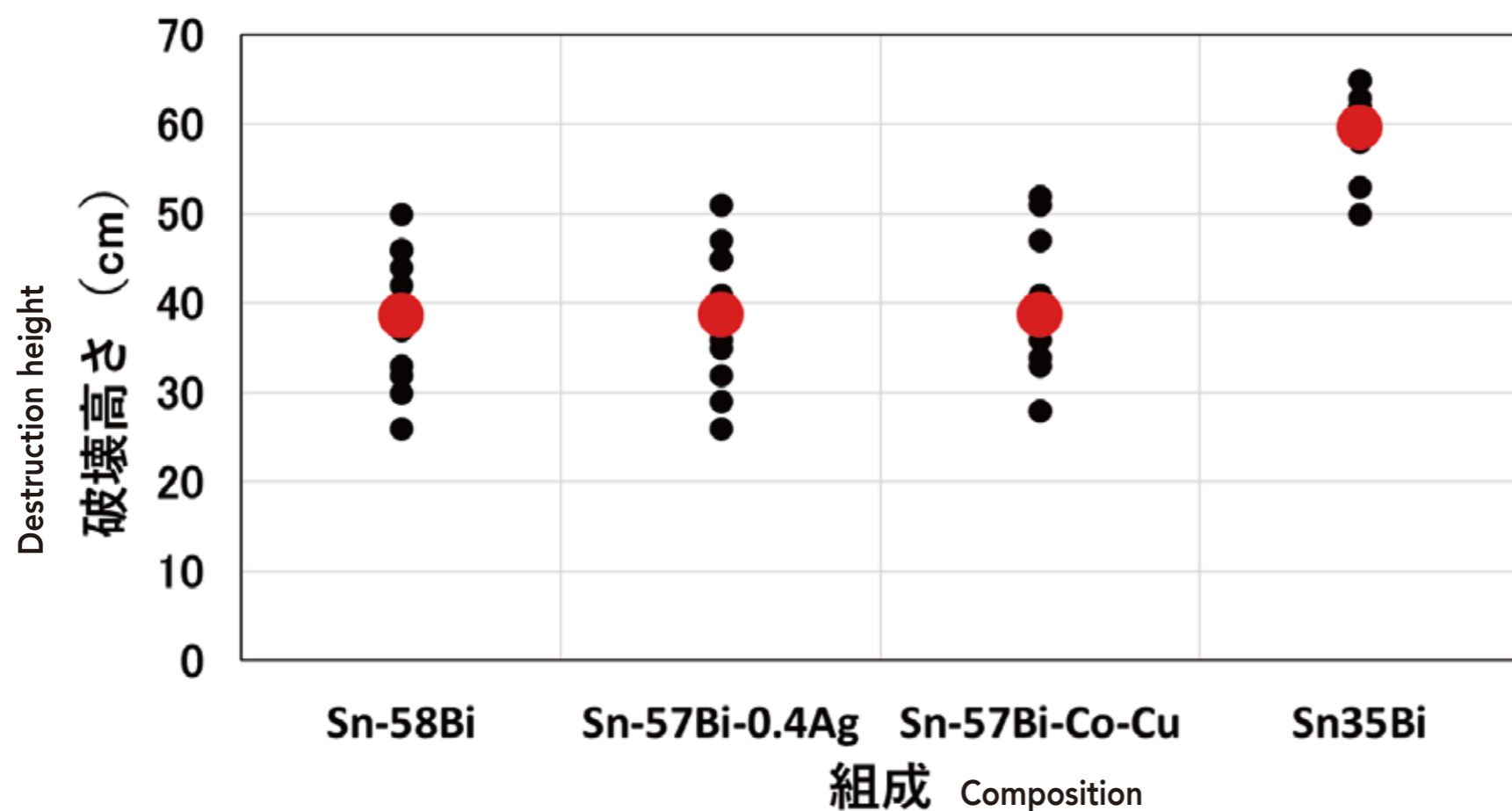


熱衝撃による劣化度合はSn-3Ag-0.5Cuと比較して同等以上

Degradation by thermal shock is equal to or greater than that of Sn-3Ag-0.5Cu

落下衝撃試験比較

Comparison at drop impact test



Sn-58Biと比較してSn-35Biは耐衝撃性が54.7%向上

Sn-35Bi has 54.7% higher impact resistance than Sn-58Bi

※ただし、リフロープロファイルの本加熱温度は190°C返上げる必要が御座います。

融点 Sn-58Bi: 139°C, Sn-35Bi: 138~187°C

However, reflow peak in the reflow profile must be increased to 190°C.

Melting point Sn-58Bi: 139°C, Sn-35Bi: 138-187°C

SB58-DPS101-T4

優れた凝集力によりレーザーはんだ付けでも飛散を低減

Excellent cohesion reduces splattering even with laser soldering methods

エリアレーザー工法にも対応

Applicable for heating by area-laser

溶融性比較(レーザーはんだ付け工法)

Comparison of melting performance (Laser soldering method)

基板: BGAφ0.5mm

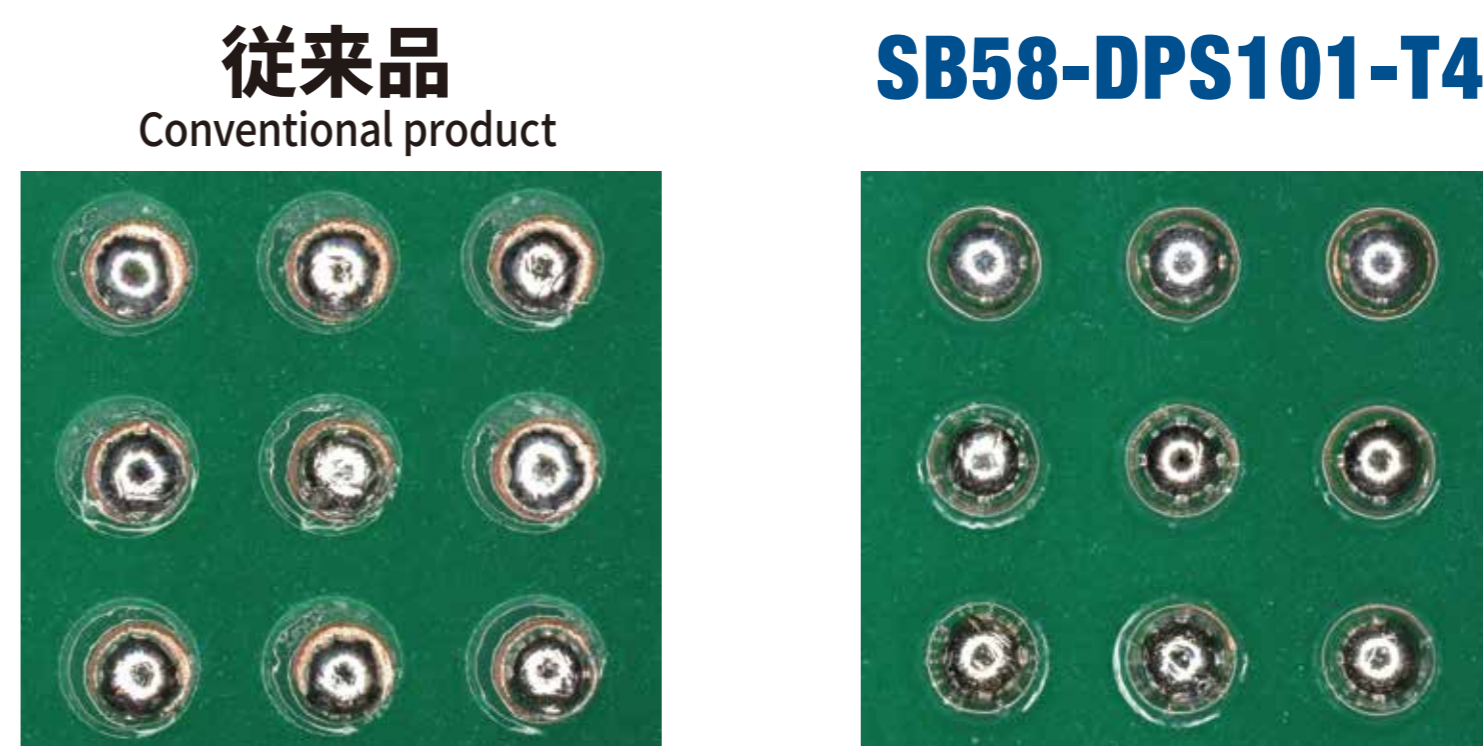
出力: 5W

時間: 3sec

Substrate: BGA φ0.5mm

Output: 5W

Time: 3sec



溶融性が良く、飛散も少ない

Good melting properties and less scattering

低融点ペーストラインナップ一覧

Low temperature solder paste lineup list

品名 Product code	金属組成 Solder composition	粉末粒径 Particle size (μm)	特長 Features
SB58-COSMO-NH-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	印刷用常温保管可能タイプ Keeping at the normal temperature is possible.
SB35-COSMO-NH-T4	Sn-35Bi	TYPE4 : 38-22	印刷用常温保管可能タイプ (リフローピーク温度190°C対応) Keeping at the normal temperature is possible.(Supports reflow peak temperature of 190°C)
SB58-DPS101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	レーザー対応 (ディスペンス、TYPE5対応可能) Laser compatible (Printing and dispensing available,TYPE5 is also available)
SB58-EPP101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	エポキシ樹脂系ペースト (印刷用、TYPE5対応可能) Epoxy resin-based solder paste(For printing ,TYPE5 is also available)
SB58-EPC101-T4	Sn-58Bi	TYPE4 : 38-22	エポキシ樹脂系ペースト (ディスペンス用、TYPE5対応可能) Epoxy resin-based solder paste(For dispensing,TYPE5 is also available)
SB6-HLGQ-20	Sn-57Bi-0.4Ag	TYPE4 : 38-22	10年の使用実績有り 10 years in use
winDot-B007-SB58	Sn-58Bi	TYPE6 : 15-5	ジェットディスペンス対応ペースト (φ160μm塗布可能) Paste for jet dispensing (φ160μm dispensable) 低融点(Sn-58Bi組成)対応ペースト! Low melting point (Sn-58Bi composition) compatible solder paste!

